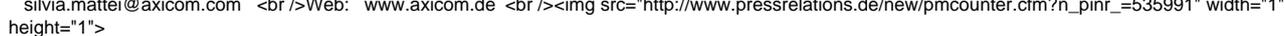




## Verbesserungen in ANSYS HFSS optimieren die elektromagnetische Simulation

Verbesserungen in ANSYS HFSS optimieren die elektromagnetische Simulation  
Neue Oberfläche für das elektrische 3D-Layout und planare MoM-Löserfunktionen sorgen für hochgenauen und automatisierten Design-Flow  
DARMSTADT - 17. Juni 2013 - Mit zunehmender Miniaturisierung und Funktionalität elektronischer Produkte wächst auch die Notwendigkeit, eine effiziente elektromagnetische Analyse zum Bestandteil des traditionellen Elektronikdesigns zu machen. Hierzu hat ANSYS (NASDAQ: ANSS) jetzt sein HFSS-Tool für die 3D-Full-Wave-Simulation elektromagnetischer Felder überarbeitet und um eine Oberfläche für das elektrische 3D-Layout ergänzt. Desweiteren wurde ein planarer Method of Moments (MoM)-Löser für einen noch genaueren, optimierten Design-Workflow hinzugefügt.  
Zusätzlich zu der traditionellen 3D-Modeler-Oberfläche bietet die neue Oberfläche für das elektrische 3D-Layout von ANSYS HFSS Version 14.5 Service Pack 2 den Entwicklern elektronischer Hochleistungsschaltungen eine wesentlich erhöhte Nutzbarkeit. Das Update erlaubt den Entwicklern, mit einer intuitiven Layout-Oberfläche schnell und einfach anspruchsvolle elektromagnetische Simulationen durchzuführen und zuverlässige, genaue und realitätsnahe Ergebnisse vom HFSS-Löser zu erhalten. Die Oberfläche für das elektrische 3D-Layout ermöglicht auch eine effizientere Integration mit etablierten EDA-Design-Flows sowie den direkten Import von Layout-Geometrie aus Layoutdatenbanken, sowie ODB++-kompatiblen Tools wie z. B. Altium, Cadence, Mentor Graphics und Zuken.  
Der neue planare MoM-Löser erlaubt den Anwendern, komplexe Berechnungen schnell durchzuführen und zu einem frühen Zeitpunkt im Design-Zyklus zahlreiche Design-Alternativen zu prüfen, wobei sie gleichzeitig auch von den ausgereiften Analysefähigkeiten von HFSS profitieren können, um das Design später zu optimieren und zu verifizieren. Funktionen zur automatischen Definition und Erstellung von Ports, zur Festlegung der Randbedingungen und der Eigenschaften von Materialschichten vereinfachen die Modellerstellung und ermöglichen den Benutzern einen einfachen Entwurf ihrer elektronischen Produkte mit der Möglichkeit vollständiger Parametrisierung von Stackups, Padstacks und Übertragungsleitungen, sowie andere Arten von planaren Strukturen und Übergängen.  
"HFSS ist ein sehr leistungsfähiges und wertvolles Tool in meinem Instrumentarium für die Simulation der Signalintegrität", sagte Steve Zinck, President von Interconnect Engineering. "Das Tool ist in der Lage, praktisch jedes Merkmal zu extrahieren, das für die Integritätsanalyse schneller Signale eine Rolle spielt. Mit der neuen Oberfläche für das elektrische 3D-Layout als Zusatz zum 3D-Modeler ist es für meine Kunden jetzt noch einfacher, äußerst zuverlässige Designs zu entwickeln."  
"Die neue Oberfläche für das elektrische 3D-Layout für ANSYS HFSS erlaubt den Anwendern die einfache Generierung vollständig parametrischer Designs von gedruckten Schaltungen, elektronischen Packages und Custom-ICs aus einer intuitiven Oberfläche heraus", sagte Larry Williams, Director of Product Management bei ANSYS. "Diese neue Fähigkeit vereinfacht die Modellerzeugung erheblich und erlaubt es einem großen Entwicklerkreis, den HFSS-Löser zur Extraktion elektromagnetischer Parameter aus kritischen Signalwegen einzusetzen sowie Design-Alternativen zu prüfen und Design-Kompromisse zu beurteilen, noch bevor die Schaltung in die Fertigung geht."  
ANSYS HFSS-Anwender können die neue Version im ANSYS-Kundenportal herunterladen.  
Über ANSYS, Inc.  
ANSYS, Inc. (Nasdaq: ANSS), gegründet 1970, entwickelt Simulationssoftware und Technologien für das Computer Aided Engineering und vermarktet sie weltweit. Die Produkte werden von Ingenieuren, Design-Entwicklern, Forschern und Studenten in einem breiten Spektrum an Branchen und wissenschaftlichen Einrichtungen eingesetzt. Der Fokus des Unternehmens liegt auf offenen und flexiblen Lösungen, die Anwendern eine Analyse und Überprüfung der Konstruktionentwürfe direkt auf ihrem Desktop ermöglichen. Zwecks zügiger, effizienter und kostenbewusster Produktentwicklung bieten sie hierzu eine universelle Plattform, die vom Design-Konzept bis zur finalen Teststufe und Validierung alle Phasen abdeckt. Das Unternehmen realisiert in Verbindung mit seinem globalen Channel-Partnernetz den Vertrieb sowie Support und Schulungen für Kunden in über 40 Ländern. Mit Sitz in Canonsburg, Pennsylvania und mehr als 65 strategisch angesiedelten Vertriebsstandorten weltweit beschäftigt ANSYS mehr als 2.400 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden sich auf [www.ansys.com](http://www.ansys.com)  
Weitere Informationen  
ANSYS Germany GmbH  
Mathias Jirka  
Birkenweg 14a,  
D-64295 Darmstadt  
Tel.: +49 (0)6151-3644-0  
E-Mail: [mathias.jirka@ansys.com](mailto:mathias.jirka@ansys.com)  
Web: [www.ansys-germany.com](http://www.ansys-germany.com)  
Pressekontakt ANSYS  
AxiCom GmbH  
Silvia Mattei  
Lilienthalstr. 5  
82178 Puchheim  
Tel.: +49 (0)89 80090 815  
E-Mail: [silvia.mattei@axicom.com](mailto:silvia.mattei@axicom.com)  
Web: [www.axicom.de](http://www.axicom.de)  


### Pressekontakt

Ansys

82178 Puchheim

[silvia.mattei@axicom.com](mailto:silvia.mattei@axicom.com)

### Firmenkontakt

Ansys

82178 Puchheim

[silvia.mattei@axicom.com](mailto:silvia.mattei@axicom.com)

Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage